

隨著先進封裝製程技術的進步，3DIC 製程中，高密度金屬凸塊製程、超厚膜光阻製程、矽導通孔(Through Silicon Via; TSV)製程屢見不鮮，當傳統 Stripper 製程設備遇到瓶頸之時，億力鑫系統科技(ELS)推出顛覆過往製程想法的新製程設備：億力鑫(ELS) J-type Stripper。

傳統 Stripper 製程中，使用化學藥液浸泡晶圓，以溶解為主要手段將光阻去除，或是以不可調節之高壓幫浦噴灑藥液將光阻去除，上述方法皆有藥液使用量大、藥液壽命短，且遇到高密度凸塊製程及超厚膜光阻製程時容易產生製程瓶頸之問題，而億力鑫(ELS)所開發之 J-type Stripper 是以擁有多國專利 TCM system 技術為核心，以 TCM system 發出的可多段調控之二流體物理衝擊力輔以低程度的化學藥液浸泡將光阻全面去除。

億力鑫(ELS) J-type Stripper 擁有多樣優點，包含降低 50% 藥液用量、一機多用，亦可用來當清洗機、產能高於傳統設備、可用製程廣泛、可調整參數多……等，綠色製造一直是近年高喊的口號，為了保存延續美好的地球，排廢的減量是人們共同希望做到的，減少的藥液用量不但可以降低成本，更可以減少排廢，達成綠色製造，永續發展的軸心理念。

在這個技術如電光石火突破的時代，擁有一台泛用性高且擁抱著新技術、高潛力的設備可以創造許多優勢，億力鑫(ELS) J-type Stripper 已驗證可以應用於：Metal lift-off、晶圓純水清洗(頑強異物：矽渣、金屬絲橋接)、超厚乾膜光阻製程(240um、120um.....等)、高密度金屬凸塊製程(凸塊間隔< 50um)、TSV 孔洞清理(將 TSV 孔洞內的矽筍、光阻清出)，已投入市場並獲得驗證，克服了許多 3DIC 的高難度製程，提升製程良率，在量產及研發兩端皆有優秀的表現。

億力鑫系統科技(ELS)以過去長期累積的合作開發的經驗，兢兢業業的對待每個客戶的需求，不遺餘力地克服各式各樣的製程問題，一同成長，是億力鑫與客戶的最佳默契。

ELS 攤位代碼：一樓 2750，現場備有實機歡迎參觀。

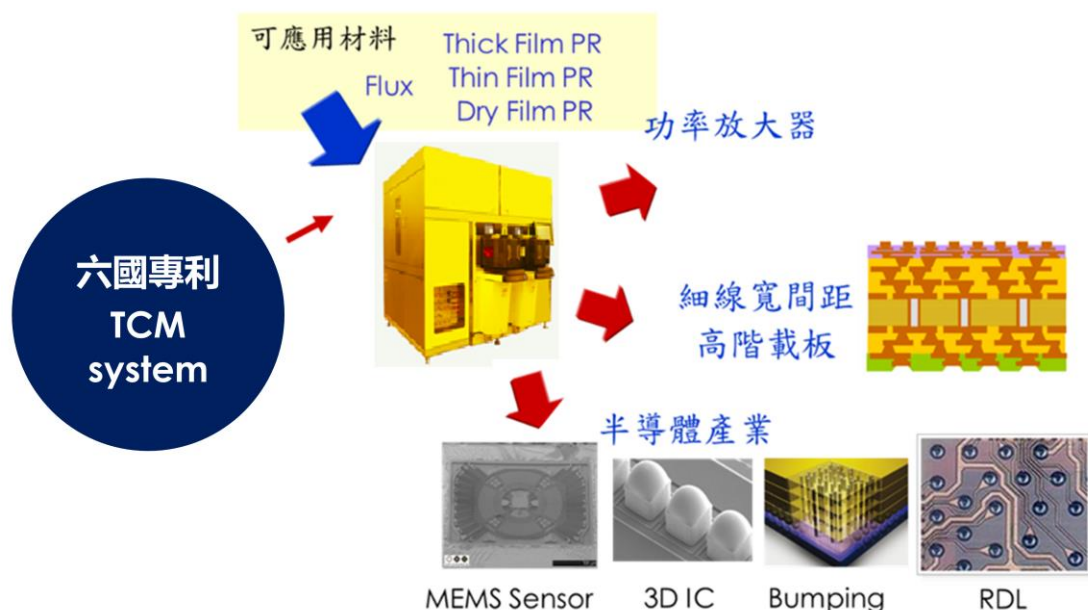


圖) 億力鑫開發之 J-type 8" & 12" Stripper。